

证券代码：002281

证券简称：光迅科技

武汉光迅科技股份有限公司

Accelink Technologies Co., Ltd.



2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年九月

本可行性分析报告（以下简称“本报告”）中如无特别说明，相关用语具有与《武汉光迅科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过350,000万元（含350,000万元），在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目	248,210.08	208,288.83
2	高速光互联及新兴光电子技术研发项目	100,060.59	61,711.17
3	补充流动资金	80,000.00	80,000.00
合计		428,270.67	350,000.00

本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资具体情况

（一）募集资金投资项目

1、项目概况

（1）算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目

①项目基本情况

本项目拟在武汉市东湖新技术开发区综合保税区厂区新建 96,834.43 平方米厂房及配套设施，购置先进生产设备，达产后形成年产高速光模块 499.20 万只、超宽带放大器 14.00 万只、相干产品 3.20 万只、高密度新型连接器 192.00 万只及光开关 0.64 万只。项目建设完成后，将有助于解决公司现有产能瓶颈，提升高端产品供货能力，充分满足客户需求，提高自身盈利水平，巩固公司在行业内的领先地位。

本项目计划投资总额为 248,210.08 万元，其中建设投资 220,498.24 万元，包含工程费用 203,490.13 万元、工程建设其他费用 4,798.70 万元、预备费 12,209.41 万元；铺底流动资金 27,711.84 万元。项目建设期为 4 年。

②项目投资概算

本项目预计总投资额为 248,210.08 万元，拟使用募集资金 208,288.83 万元，项目投资概算情况如下表所示：

序号	项目	投资金额（万元）	占比（%）
一	建设投资	220,498.24	88.84%
1	工程费用	203,490.13	81.98%
1.1	建筑工程费	53,625.66	21.60%
1.2	软硬件购置费及安装费	149,864.47	60.38%
2	工程建设其他费用	4,798.70	1.93%
3	预备费	12,209.41	4.92%
二	铺底流动资金	27,711.84	11.16%
合计	项目总投资	248,210.08	100.00%

经测算，本项目税后内部收益率为 17.20%，税后静态投资回收期为 7.85 年（含建设期 4 年），项目预测效益良好。

③项目报批程序

截至预案出具日，本项目备案及环评涉及的相关手续正在办理过程中。

（2）高速光互联及新兴光电子技术研发项目

①项目基本情况

本项目拟在武汉市东湖新技术开发区综合保税区厂区建设国内先进、与公司发展相匹配的光电子研发中试中心 7,316.65 平方米，新增研发及检测设备、实验设备等，这将有助于提升公司研发质量、缩短研发周期，加快公司自主研发的进程，并为公司提供充足的新产品技术储备。项目实施完成后，公司将在高速光互连、新兴光电子等领域开展技术研究及中试，聚焦行业及下游应用领域的前沿技术，以增强公司的技术研发实力。

本项目总投资 100,060.59 万元，其中建设投资 65,271.59 万元，包括工程费用 59,340.46 万元、工程建设其他费用 2,370.71 万元、预备费 3,560.42 万元；研发费用 34,789.00 万元。项目建设期为 3 年。

②项目投资概算

本项目预计总投资额为 100,060.59 万元，拟使用募集资金 61,711.17 万元，项目投资概算情况如下表所示：

序号	项目	投资金额（万元）	占比
一	建设投资	65,271.59	65.23%
1	工程费用	59,340.46	59.30%
1.1	建筑工程费	28,716.20	28.70%
1.2	软硬件设备购置及安装费	30,624.26	30.61%
2	工程建设其他费用	2,370.71	2.37%
3	预备费	3,560.42	3.56%
二	研发费用	34,789.00	34.77%
	合计	100,060.59	100.00%

③项目报批程序

截至预案出具日，本项目备案及环评涉及的相关手续正在办理过程中。

2、项目必要性分析

（1）紧抓 AI 算力核心硬件需求，弥补高端产品产能缺口

当前全球 AI 竞赛白热化，算力为核心驱动力，而高速光互连网络是算力集群的物理基础。根据 LightCounting 预测¹，目前占据全球光模块最大比例的数通市场规模 2025 年将达到 154 亿美元，未来五年整个行业复合增速超过 13%，预计到 2029 年市场规模将超过 258 亿美元，市场前景广阔。与日益增长的光模块市场需求相比，公司产能不足问题日益凸显。

本次募投项目针对明确市场缺口的算力中心光连接及高速光传输产品进行产能扩充，既是公司响应全球 AI 算力需求、填补高端产品产能缺口的必要举措，也是公司强化技术优势、提升产业链韧性的关键布局。

（2）丰富产品矩阵，提升公司整体竞争力与抗风险能力

当前，全球 AI 技术加速渗透、数字经济深度转型，光通信行业正面临技术迭代提速、市场需求多元、供应链风险复杂的多重挑战，构建覆盖核心场景、技术壁垒显著的产品矩阵，已成为企业提升市场竞争力、抵御周期风险的关键路径。本次募投项目布局产品可形成“算力终端-传输链路-骨干网络”全场景覆盖，如高速光模块与新型高密度连接器满足近距传输需求，相干模块与超宽带放大器满足远距传输需求，各产品在技术研发、供应链采购、客户服务等方面协同效应显著。

本次募投项目的实施是公司通过产品矩阵协同效应与产业链垂直整合提升核心竞

¹ LightCounting Market Forecast Report - October 2024

争力与抗风险能力的必要途径，是助力我国算力基础设施自主可控与数字经济高质量发展的必然要求，其建设具有必要性。

(3) 突破前沿技术瓶颈，确保公司在下一代算力中心领域技术领先

当前全球人工智能和大模型训练正在推动算力需求呈现指数级增长，同时下一代算力中心对数据传输的“带宽、时延、能耗”提出更高要求——传输速率从当前的 400G、800G 向 1.6T 及更高速率加速演进。为此公司亟须加大研发力度突破前沿技术瓶颈，重点开发下一代可插拔光模块和 CPO（共封装光学）光引擎及其配套光器件，以在下一代算力中心/数据中心市场竞争中保持技术领先。

(4) 培育多元化的光电子应用技术，打造公司未来第二增长曲线

当前公司主营业务主要集中在光通信市场，而以光采集、光连接、光算存、光呈现为代表的信息光子技术具备万亿级市场空间，贯穿信息生命周期全过程。在人工智能、6G、车载光通信等各类新兴业务及应用需求牵引驱动下，以及新型光子材料与先进制造封装工艺有效支撑下，信息光子技术迭代将明显加速，满足更多元化场景需求，市场规模将持续增长。在此背景下，公司拟开拓新兴光电子领域，通过培育新的业务增长点，构建“双轮驱动”甚至“多轮驱动”的发展格局，不仅是公司应对传统市场风险、突破发展瓶颈的必然选择，更是抢占新兴领域战略高地、打造未来第二增长曲线的关键举措。通过构建多元化的业务结构，公司将实现从“光通信单一领域深耕”向“多领域光电子布局”的转型，进一步提升核心竞争力和市场抗风险能力。

3、项目可行性分析

(1) AI 算力需求爆发直接带动算力中心光连接及高速光传输产品需求激增

当前全球云服务商持续加大 AI 数据中心投入，其中，美国四大云服务提供商（亚马逊、谷歌、Meta 和微软）2025 年计划投入超 3000 亿美元；中国云服务提供商支出目前与美国相比仍有较大差距，但受国内算力需求爆发及政策支持刺激，国内互联网厂商逐步加大对 AI 相关业务的投入，2025 第一季度我国三大云厂商阿里巴巴、百度、腾讯资本开支合计为 549.9 亿元，同比增长 99.6%，未来国内云服务商支出的潜力巨大。高速光互联产品作为实现高速、稳定数据传输的关键部件，市场需求呈现出井喷式增长。根据咨询机构 Omdia²的报告预测，全球光器件市场规模将由 2024 年的 300 亿美金增长至 2029 年的 520 亿美金，增长趋势迅猛。公司此次募投项目的相关产品是 AI 数据中心内部及跨中心互联的关键硬件，是对现有客户需求的直接产能响应，市场前景广阔。

² Omdia: Total Optical Components Forecast 2024-2029 forecast

(2) 公司拥有较高的品牌影响力和优质稳定的客户资源

在客户资源与市场覆盖方面，公司已构建“全系列产品+多维度技术”服务体系，同时拥有全球化、高质量的客户网络，客户资源丰富且合作关系稳固。公司产品已全面覆盖全球知名通信服务商与互联网厂商，在 AI 智算中心等新兴领域已占据有利地位，客户合作场景持续拓展，进一步凸显公司在客户资源方面的广度与深度，为本次募投项目产能消化提供了重要保障。

(3) 公司具备扎实的技术积累和研发平台支撑

公司经过多年技术积累，已构建完善研发体系与技术平台。其一，拥有涵盖半导体材料生长、半导体工艺与平面光波导技术、光学设计与高密封装技术、热分析与机械设计技术、高频仿真与设计技术、软件控制与子系统开发技术六大核心技术工艺平台，各平台协同形成“基础材料-产品设计-高可靠性封装”完整技术链，为研发提供全方位支撑；其二，具备从芯片到子系统的全产业链垂直集成能力，可实现由芯片、部件、基础器件到模块、子系统的多层次研究开发，可快速响应项目需求并灵活适配多样化产品开发；其三，公司研发实力雄厚，承担 230 余项国家级项目，累计申请国内外专利 3,000 余项，参与制定标准 290 余项，为项目研发奠定坚实基础。

(4) 拥有高素质的研发团队和人才培养体系

公司充分应用现代企业培训理念，已建立了完善的人才管理体系。公司研发团队实力雄厚，拥有包括 IEC 专家在内的众多技术领军人才，目前公司研发人员数量超过 1200 人，核心成员平均拥有 10 年以上光电子领域研发经验，人才储备充足。与此同时，公司建立了贯穿员工全周期的系统化培养体系如“领航计划”，针对顶尖高校优秀毕业生，通过定制化的轮岗实践、导师一对一辅导（公司技术专家担任）、参与关键技术攻关项目，加速其成长为技术骨干。公司目前高素质的研发团队和完善的人才培养体系为本次募投项目的实施奠定了扎实的基础。

(二) 补充流动资金

1、项目概况

为满足公司日常经营资金需要，公司拟将本次发行募集资金 80,000.00 万元用于补充流动资金。

2、项目必要性及可行性分析

(1) 必要性

①公司生产经营规模的扩大需要补充流动资金

2022 年、2023 年、2024 年公司营业收入复合增长率为 9.40%，营业收入保持稳定增长态势。随着营业收入的增长，公司的应收票据和应收账款余额、存货余额均会进一步增加，需要更多的营运资金来支撑生产经营规模的增长。

②优化资本结构，提升抗风险能力

公司面临市场竞争风险、宏观经济波动风险等各项风险因素，募集资金用于补充流动资金可以优化公司的资本结构，提高公司风险抵御能力；同时也有助于公司抢占市场先机，避免因资金短缺而失去发展机会。

(2) 可行性

①本次发行符合相关法律法规和规范性文件规定的条件

本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律法规和规范性文件的规定，具有可行性。

②公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系

公司已按照上市公司治理标准建立了规范的公司治理体系，健全了各项规章制度和内控制度，并在日常生产经营过程中不断地改进和完善。同时，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

(一) 本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司综合实力。本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，能够提升公司盈利水平，进一步增强公司的核心竞争力，实现公司的长期可持续发展，巩固和提升公司的行业地位，实现公司的战略目标。

(二) 本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将同步增加，资产负债率水平将有所下降，有利于增强公司抵御财务风险的能力，进一步优化资产结构，降低财务成本和财务风险，增强未来的持续经营能力。随着募集资金投资项目的完成，可进一步扩大公司主

营业务规模，项目效益将逐步显现，进一步改善公司财务状况。

四、本次募集资金投资项目可行性分析结论

公司董事会认为，公司本次发行的募集资金投向符合国家相关政策和法律法规、行业发展趋势以及公司发展战略。本次募集资金投资项目的实施，将进一步优化公司资本结构，提升公司综合实力，为公司持续发展提供支撑，符合公司及全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要且可行的。

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月十日